

半导体湿法工艺蚀刻及基板搬运可定制方形聚四氟乙烯硅片清洗花篮

货号: PL-CP88



简介

专为硅片加工设计的高纯聚四氟乙烯方形清洗花篮。这款耐腐蚀支架可保障半导体制造中湿法蚀刻与基板搬运的安全，支持全尺寸与结构定制，满足实验室或工业湿台的特定使用需求。

[了解更多](#)

应用场景	说明	核心优势
半导体制造	硅片浸泡在RCA清洗液或食人鱼蚀刻液中去除污染物。	无金属污染风险
光伏电池生产	大尺寸太阳能硅片制绒与酸抛光工序中的承载转运。	批量加工能力强，耐用性高
MEMS器件加工	在多工位湿台中安全转运易碎微机电基板。	基板定位精准
LCD/OLED玻璃清洗	薄膜沉积前对导电玻璃基板（ITO/FTO）进行清洗。	耐玻璃清洗剂腐蚀
高纯实验室研究	痕量分析与强化学消解过程中的样品承载。	耐受腐蚀性介质性能优异
纳米技术基板	科研环境中绝缘体上硅（SOI）或蓝宝石晶圆加工。	对脆性材料损伤小

参数类别	PL-CP88参数详情
型号标识	PL-CP88
主体材料	高纯聚四氟乙烯（PTFE）
标准尺寸	249mm × 249mm（可按需定制尺寸）
结构形式	方形框花篮设计
定制选项	卡槽数量、卡槽宽度、卡槽深度、间距、把手样式
工作温度范围	-200°C 至 +260°C
耐化学性	通用耐腐（熔融碱金属和高压氟除外）
加工方式	全流程CNC精密加工，实现高公差规格要求
表面处理	光滑无孔隙氟聚合物表面
兼容性	适配手动浸泡槽与自动化机械湿台臂